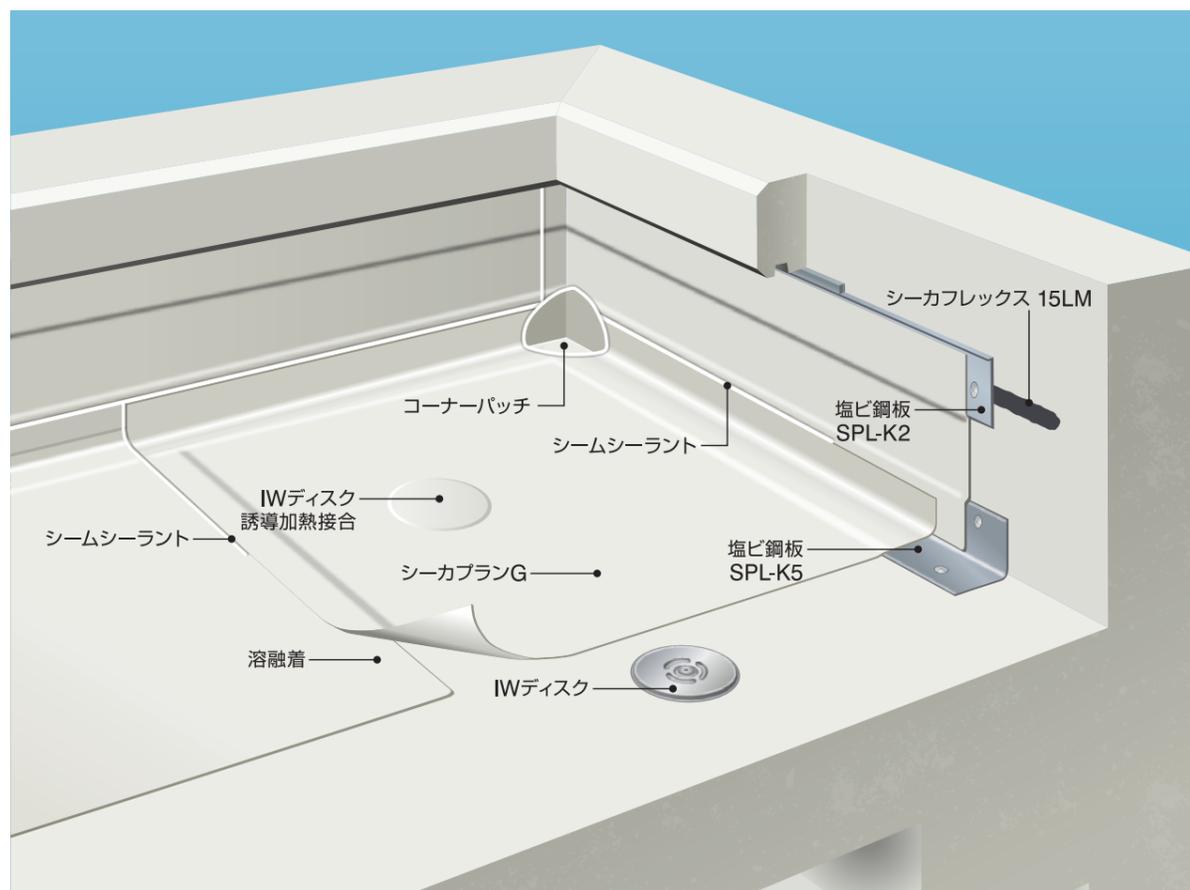


# 1. 機械的固定工法

## IW工法 (立上り部: 機械的固定)

システム記号	シート厚み	高反射	用途		適応下地	
			非歩行	歩行	RC	ALC
12G-IW	1.2	-	●	-	●	-
15G-IW	1.5	-	●	-	●	●
15GW-IW	1.5	●	●	-	●	●
20G-IW	2.0	-	●(ALC)	●	●	●
20GW-IW	2.0	●	●(ALC)	●	●	●

公共建築工事標準仕様書 S-M2  
 公共建築改修工事標準仕様書 S-M2  
 日本建築学会 JASS 8 S-PM



### ■ 施工手順

1. 絶縁シート敷設(必要な場合)	SPLマット、SPLエマルジョン100
2. 塩ビ鋼板、IWディスク盤固定	SPL-K各種、IWディスク、SPLアンカー、スクリュー
3. シーカブランG敷設	シーカブランG (高反射タイプ含む)
4. 溶融着接合	溶融着、シームシーラント
5. 誘導加熱接合	Sika-IW-01J
6. 端末処理	SPL-K各種、シーカフレックス各種、プチルテープ、SPLアンカー、スクリュー

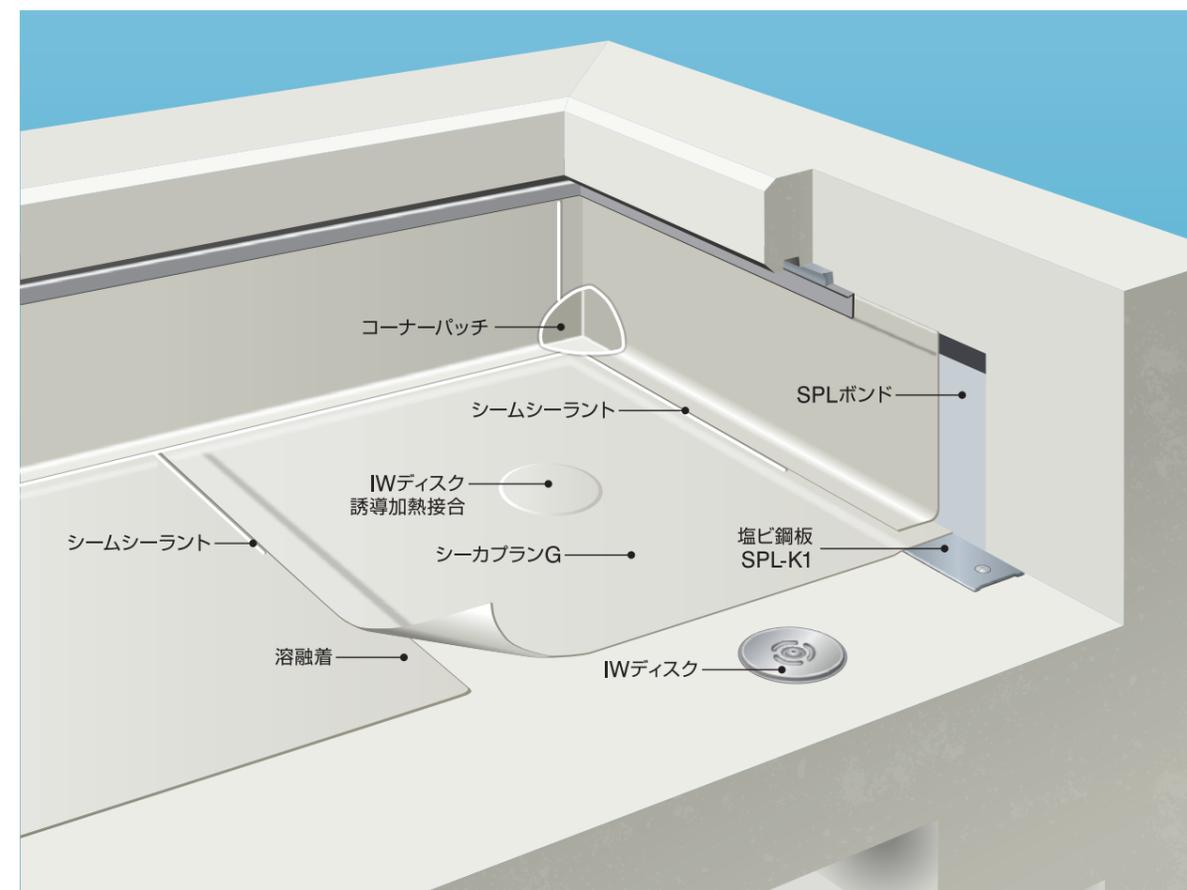
- ※注意事項
- ・高層の建物(30m以上)や海岸地域に近い建物は別途IWディスク割付の検討が必要です。
  - ・下地がALCパネルの場合、エポキシ樹脂を下穴に注入する必要があります。
  - ・入隅部の納めは逆張り(平場シート後張り)のほか、順張り(平場シート先張り)も可能です。
  - ・シートの厚みが2.0mmの場合は、歩行可能です。(但し、ALCパネル下地を除く)
  - ・改修工事の場合、既存下地とシーカブランGの間にSPLマットが必要です。
  - ・裏打シール処理は、公共建設工事の場合、新築・改修共にプチルテープを使用する場合があります。

# 2. 機械的固定工法

## IW工法 (立上り部: 接着)

システム記号	シート厚み	高反射	用途		適応下地	
			非歩行	歩行	RC	ALC
12G-IW	1.2	-	●	-	●	-
15G-IW	1.5	-	●	-	●	●
15GW-IW	1.5	●	●	-	●	●
20G-IW	2.0	-	●(ALC)	●	●	●
20GW-IW	2.0	●	●(ALC)	●	●	●

公共建築工事標準仕様書 S-M2  
 公共建築改修工事標準仕様書 S-M2  
 日本建築学会 JASS 8 S-PM



### ■ 施工手順

1. 絶縁シート敷設(必要な場合)	SPLマット、SPLエマルジョン100
2. 塩ビ鋼板、IWディスク盤固定	SPL-K各種、IWディスク、SPLアンカー、スクリュー
3. シーカブランG敷設	シーカブランG (高反射タイプ含む)
4. 溶融着接合	溶融着、シームシーラント
5. 誘導加熱接合	Sika-IW-01J
6. 端末処理	SPL-A各種、シーカフレックス各種、フィッシャー N5×30FZ、プチルテープ

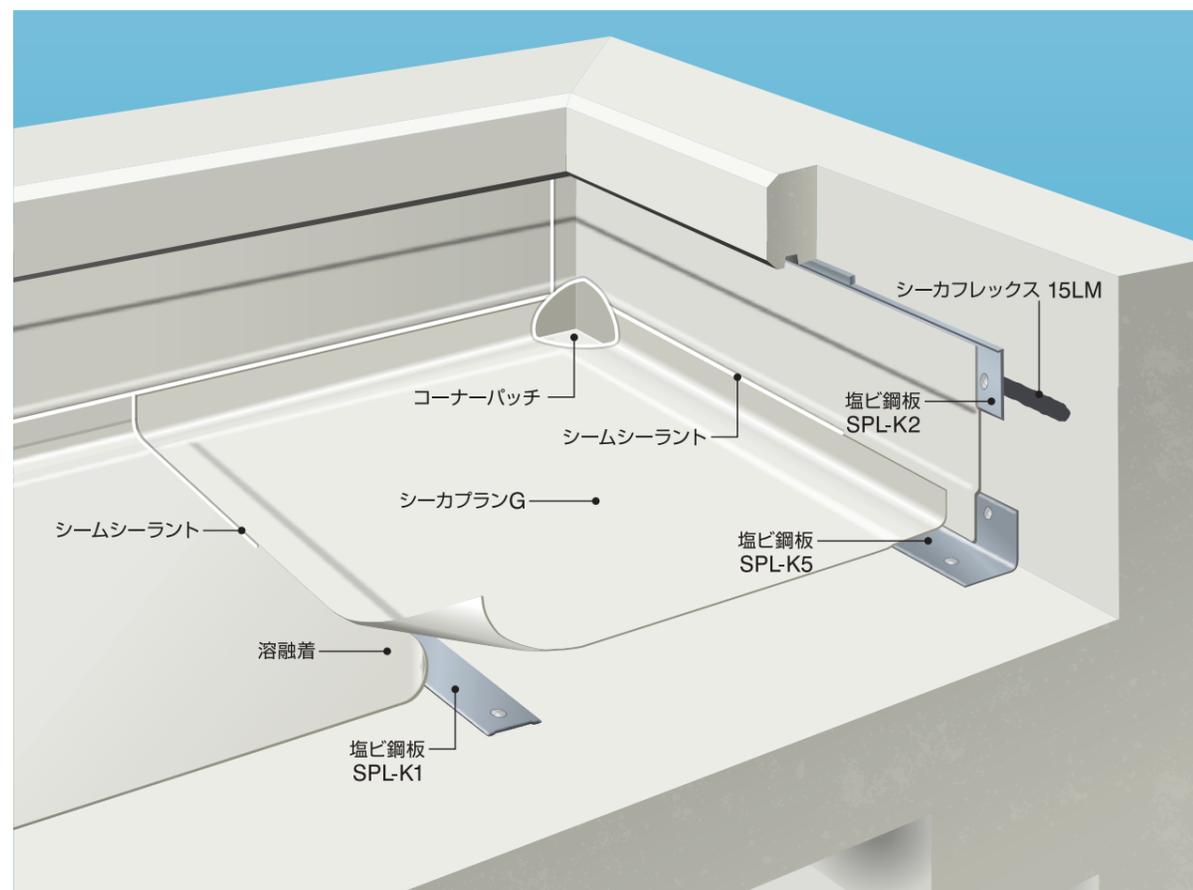
- ※注意事項
- ・高層の建物(30m以上)や海岸地域に近い建物は別途IWディスク割付の検討が必要です。
  - ・下地がALCパネルの場合、エポキシ樹脂を下穴に注入する必要があります。
  - ・シートの厚みが2.0mmの場合は、歩行可能です。(但し、ALCパネル下地を除く)
  - ・改修工事の場合、既存下地とシーカブランGの間にSPLマットが必要です。

### 3. 機械的固定工法

#### パー工法 (立上り部: 機械的固定)

システム記号	シート厚み	高反射	用途		適応下地	
			非歩行	歩行	RC	ALC
12G-B	1.2	-	●	-	●	-
15G-B	1.5	-	●	-	●	-
15GW-B	1.5	●	●	-	●	-
20G-B	2.0	-	●	●	●	-
20GW-B	2.0	●	●	●	●	-

公共建築工事標準仕様書 S-M2  
 公共建築改修工事標準仕様書 S-M2  
 日本建築学会 JASS 8 S-PM



#### ■ 施工手順

1. 絶縁シート敷設(必要な場合)	SPLマット、SPLエマルジョン100
2. 塩ビ鋼板	SPL-K各種、SPLアンカー、スクリュー
3. シーカプランG敷設	シーカプランG (高反射タイプ含む)
4. 融融着接合	融融着、シームシーラント
5. 端末処理	SPL-K各種、シーカフレックス各種、プチルテープ、SPLアンカー、スクリュー

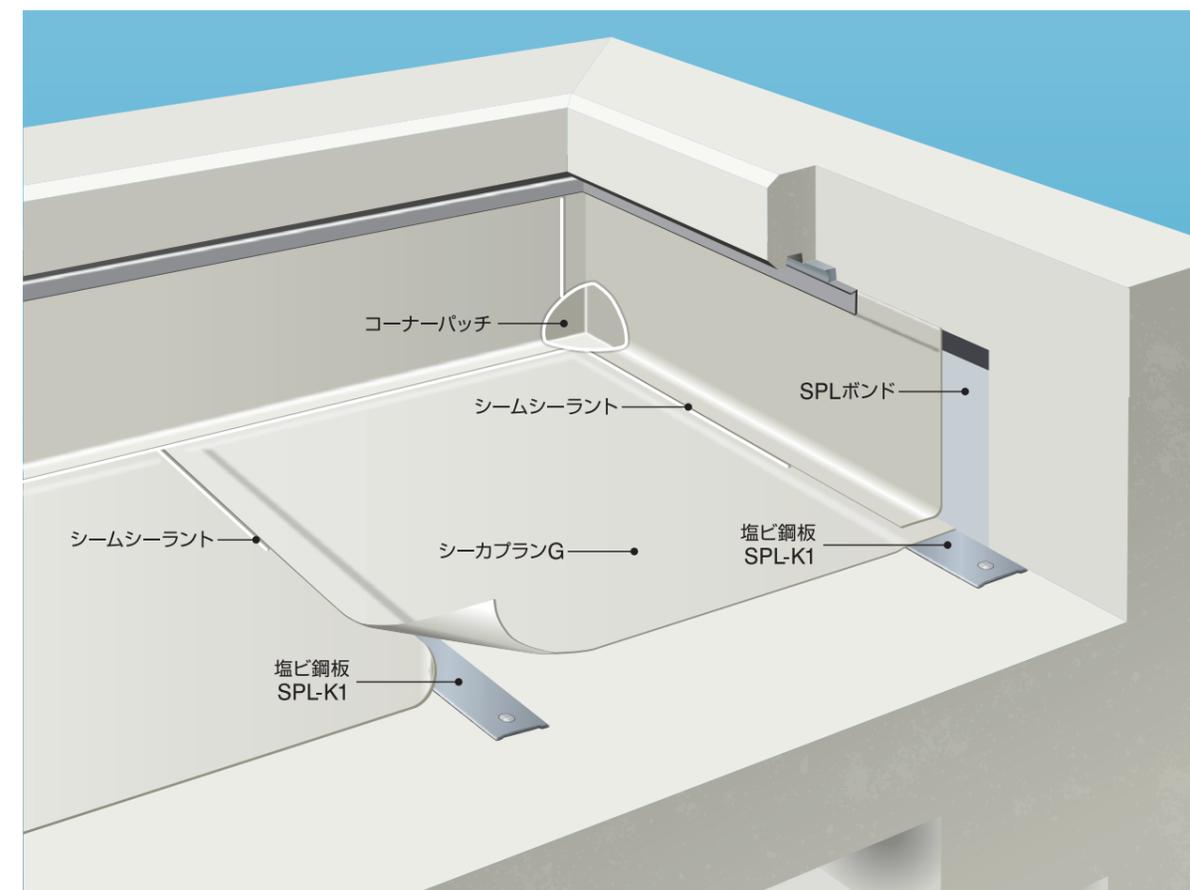
- ※注意事項
- ・高層の建物(30m以上)や海岸地域に近い建物は別途アンカーの固定数を増やす必要があります。
  - ・下地がALCパネルの場合は本工法は適用しません。
  - ・入隅部の納めは逆張り(平場シート後張り)のほか、順張り(平場シート先張り)も可能です。
  - ・改修工事の場合、既存下地とシーカプランGの間にSPLマットが必要です。
  - ・裏打シル処理は、公共建設工事の場合、新築・改修共にプチルテープを使用する場合があります。

### 4. 機械的固定工法

#### パー工法 (立上り部: 接着)

システム記号	シート厚み	高反射	用途		適応下地	
			非歩行	歩行	RC	ALC
12G-B	1.2	-	●	-	●	-
15G-B	1.5	-	●	-	●	-
15GW-B	1.5	●	●	-	●	-
20G-B	2.0	-	●	●	●	-
20GW-B	2.0	●	●	●	●	-

公共建築工事標準仕様書 S-M2  
 公共建築改修工事標準仕様書 S-M2  
 日本建築学会 JASS 8 S-PM



#### ■ 施工手順

1. 絶縁シート敷設(必要な場合)	SPLマット、SPLエマルジョン100
2. 塩ビ鋼板	SPL-K各種、SPLアンカー、スクリュー
3. シーカプランG敷設	シーカプランG (高反射タイプ含む)
4. 融融着接合	融融着、シームシーラント
5. 端末処理	SPL-A各種、シーカフレックス各種、フィッシャー N5×30FZ、プチルテープ

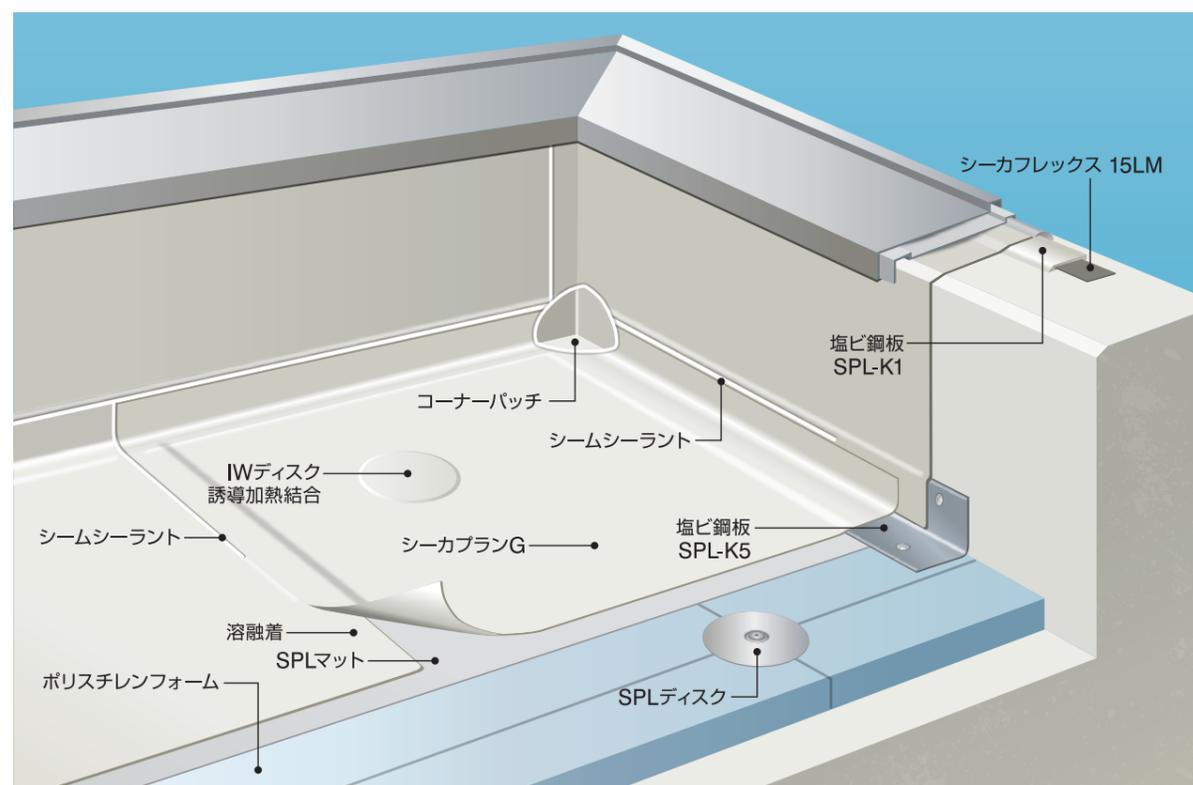
- ※注意事項
- ・高層の建物(30m以上)や海岸地域に近い建物は別途アンカーの固定数を増やす必要があります。
  - ・下地がALCパネルの場合は本工法は適用しません。
  - ・改修工事の場合、既存下地とシーカプランGの間にSPLマットが必要です。

## 5. 機械的固定工法

### IW断熱工法（立上り部：機械的固定） ポリスチレンフォーム

システム記号	シート厚み	断熱材種類	高反射	用途		適応下地	
				非歩行	歩行	RC	ALC
12G-IW-S	1.2	ポリスチレン	-	●	-	●	-
15G-IW-S	1.5	ポリスチレン	-	●	-	●	-
15GW-IW-S	1.5	ポリスチレン	●	●	-	●	-
20G-IW-S	2.0	ポリスチレン	-	●	-	●	-
20GW-IW-S	2.0	ポリスチレン	●	●	-	●	-

公共建築工事標準仕様書 SI-M2  
 公共建築改修工事標準仕様書 SI-M2  
 日本建築学会 JASS 8 S-PMT



#### ■ 施工手順

1. 断熱材の敷設	ポリスチレンフォーム、SPLディスク、スクリュー
2. 絶縁シート敷設	SPLマット、SPLエマルジョン100、SPLテープ
3. 塩ビ鋼板、IWディスク盤固定	SPL-K各種、IWディスク、SPLアンカー、スクリュー、IWディスクスペーサー
4. シーカプランG敷設	シーカプランG (高反射タイプ含む)
5. 溶融着接合	溶融着、シームシーラント
6. 誘導加熱接合	Sika-IW-01J
7. 端末処理	SPL-K各種、シーカフレックス各種、プチルテープ、SPLアンカー、スクリュー

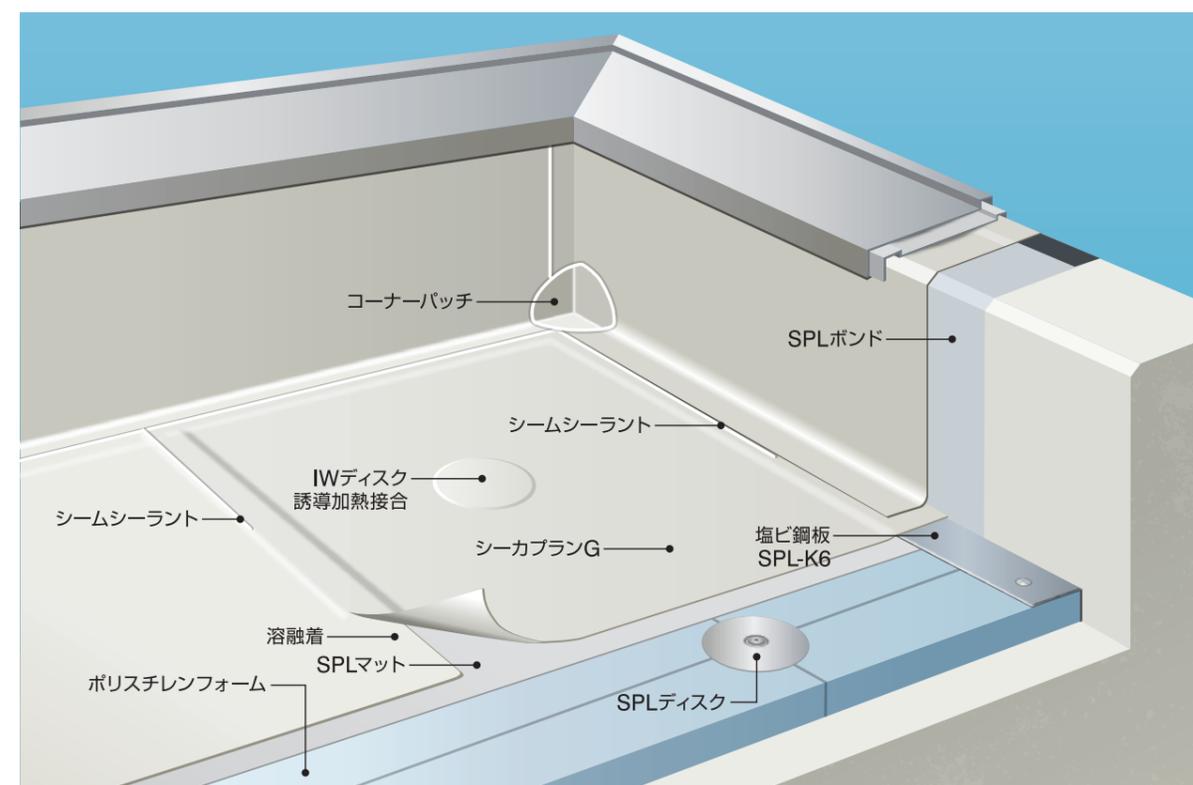
- ※注意事項
- ・高層の建物(30m以上)や海岸地域に近い建物は別途IWディスク割付の検討が必要です。
  - ・IWディスクの下に必ずIWディスクスペーサーを設置してください。
  - ・入隅部の納めは逆張り(平場シート後張り)のほか、順張り(平場シート先張り)も可能です。
  - ・非歩行仕様です。
  - ・断熱材の厚みは50mm以下です。
  - ・既存下地と断熱材の間にSPL防湿シートを敷設する場合があります。
  - ・裏打シール処理は、公共建設工事の場合、新築・改修共にプチルテープを使用する場合があります。

## 6. 機械的固定工法

### IW断熱工法（立上り部：接着） ポリスチレンフォーム

システム記号	シート厚み	断熱材種類	高反射	用途		適応下地	
				非歩行	歩行	RC	ALC
12G-IW-S	1.2	ポリスチレン	-	●	-	●	-
15G-IW-S	1.5	ポリスチレン	-	●	-	●	-
15GW-IW-S	1.5	ポリスチレン	●	●	-	●	-
20G-IW-S	2.0	ポリスチレン	-	●	-	●	-
20GW-IW-S	2.0	ポリスチレン	●	●	-	●	-

公共建築工事標準仕様書 SI-M2  
 公共建築改修工事標準仕様書 SI-M2  
 日本建築学会 JASS 8 S-PMT



#### ■ 施工手順

1. 断熱材の敷設	ポリスチレンフォーム、SPLディスク、スクリュー
2. 絶縁シート敷設	SPLマット、SPLエマルジョン100、SPLテープ
3. 塩ビ鋼板、IWディスク盤固定	SPL-K各種、IWディスク、SPLアンカー、スクリュー、IWディスクスペーサー
4. シーカプランG敷設	シーカプランG (高反射タイプ含む)
5. 溶融着接合	溶融着、シームシーラント
6. 誘導加熱接合	Sika-IW-01J
7. 端末処理	SPL-A各種、シーカフレックス各種、フィッシャー N5×30FZ、プチルテープ

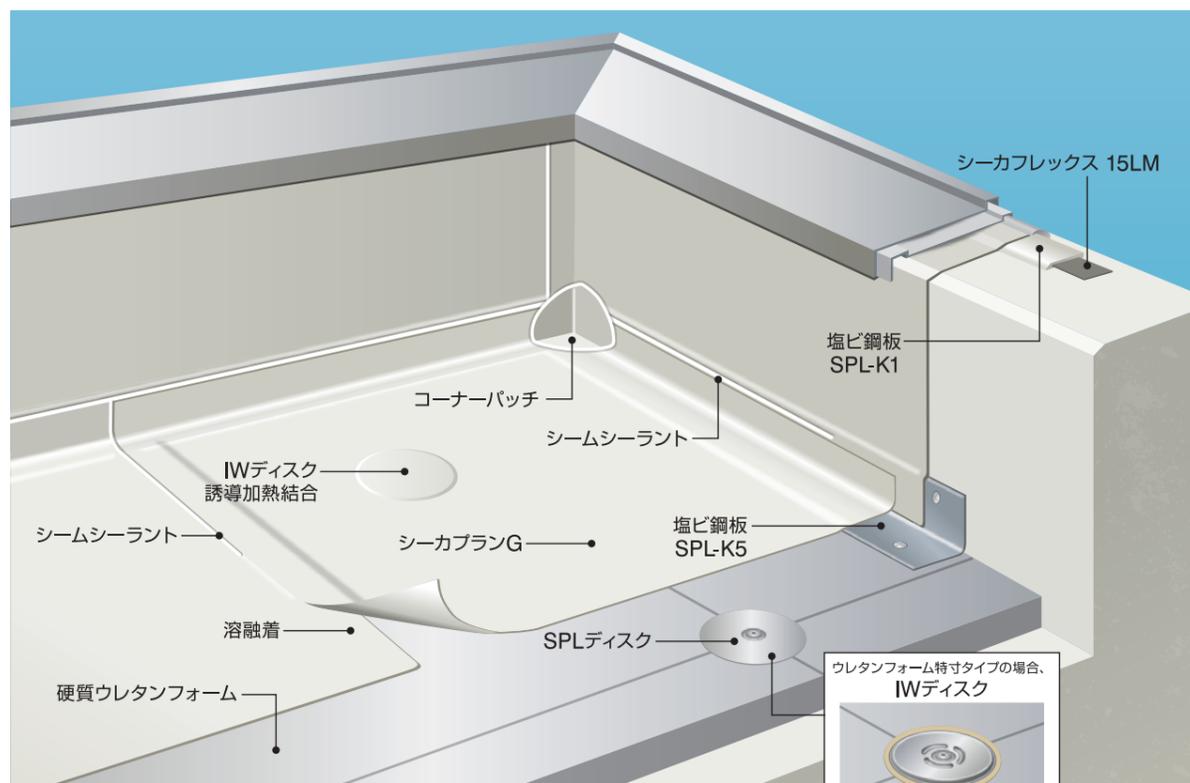
- ※注意事項
- ・高層の建物(30m以上)や海岸地域に近い建物は別途IWディスク割付の検討が必要です。
  - ・IWディスクの下に必ずIWディスクスペーサーを設置してください。
  - ・非歩行仕様です。
  - ・断熱材の厚みは50mm以下です。
  - ・既存下地と断熱材の間にSPL防湿シートを敷設する場合があります。

## 7. 機械的固定工法

### IW断熱工法（立上り部：機械的固定） 硬質ウレタンフォーム

システム記号	シート厚み	断熱材種類	高反射	用途		適応下地	
				非歩行	歩行	RC	ALC
12G-IW-UR	1.2	硬質ウレタン	-	●	-	●	-
15G-IW-UR	1.5	硬質ウレタン	-	●	-	●	-
15GW-IW-UR	1.5	硬質ウレタン	●	●	-	●	-
20G-IW-UR	2.0	硬質ウレタン	-	●	-	●	-
20GW-IW-UR	2.0	硬質ウレタン	●	●	-	●	-

公共建築工事標準仕様書 SI-M2  
 公共建築改修工事標準仕様書 SI-M2  
 日本建築学会 JASS 8 S-PMT



特寸タイプの割付はP32をご参照下さい。

#### ■ 施工手順

1. 断熱材の敷設	硬質ウレタンフォーム、SPLディスク、スクリュー
2. 塩ビ鋼板、IWディスク盤固定	SPL-K各種、IWディスク、SPLアンカー、スクリュー、IWディスクスペーサー
3. シーカブランG敷設	シーカブランG (高反射タイプ含む)
4. 溶融着接合	溶融着、シームシーラント
5. 誘導加熱接合	Sika-IW-01J
6. 端末処理	SPL-K各種、シーカフレックス各種、プチルテープ、SPLアンカー、スクリュー

#### ※注意事項

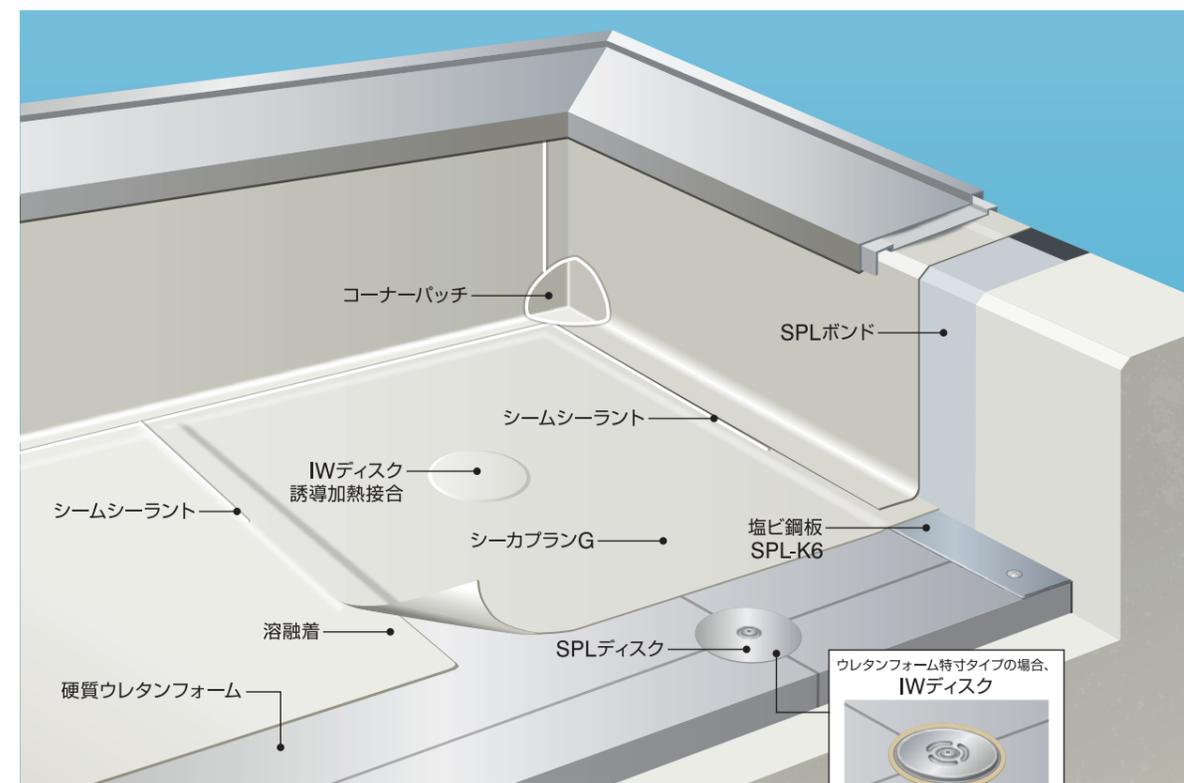
- ・高層の建物(30m以上)や海岸地域に近い建物は別途IWディスク割付の検討が必要です。
- ・IWディスクの下に必ずIWディスクスペーサーを設置してください。
- ・入隅部の納めは逆張り(平場シート後張り)のほか、順張り(平場シート先張り)も可能です。
- ・非歩行仕様です。
- ・断熱材の厚みは50mm以下です。
- ・既存下地と断熱材の間にSPL防湿シートを敷設する場合があります。
- ・裏打シール処理は、公共建設工事の場合、新築・改修共にプチルテープを使用する場合があります。

## 8. 機械的固定工法

### IW断熱工法（立上り部：接着） 硬質ウレタンフォーム

システム記号	シート厚み	断熱材種類	高反射	用途		適応下地	
				非歩行	歩行	RC	ALC
12G-IW-UR	1.2	硬質ウレタン	-	●	-	●	-
15G-IW-UR	1.5	硬質ウレタン	-	●	-	●	-
15GW-IW-UR	1.5	硬質ウレタン	●	●	-	●	-
20G-IW-UR	2.0	硬質ウレタン	-	●	-	●	-
20GW-IW-UR	2.0	硬質ウレタン	●	●	-	●	-

公共建築工事標準仕様書 SI-M2  
 公共建築改修工事標準仕様書 SI-M2  
 日本建築学会 JASS 8 S-PMT



特寸タイプの割付はP32をご参照下さい。

#### ■ 施工手順

1. 断熱材の敷設	硬質ウレタンフォーム、SPLディスク、スクリュー
2. 塩ビ鋼板、IWディスク盤固定	SPL-K各種、IWディスク、SPLアンカー、スクリュー、IWディスクスペーサー
3. シーカブランG敷設	シーカブランG (高反射タイプ含む)
4. 溶融着接合	溶融着、シームシーラント
5. 誘導加熱接合	Sika-IW-01J
6. 端末処理	SPL-A各種、シーカフレックス各種、フィッシャー N5×30FZ、プチルテープ

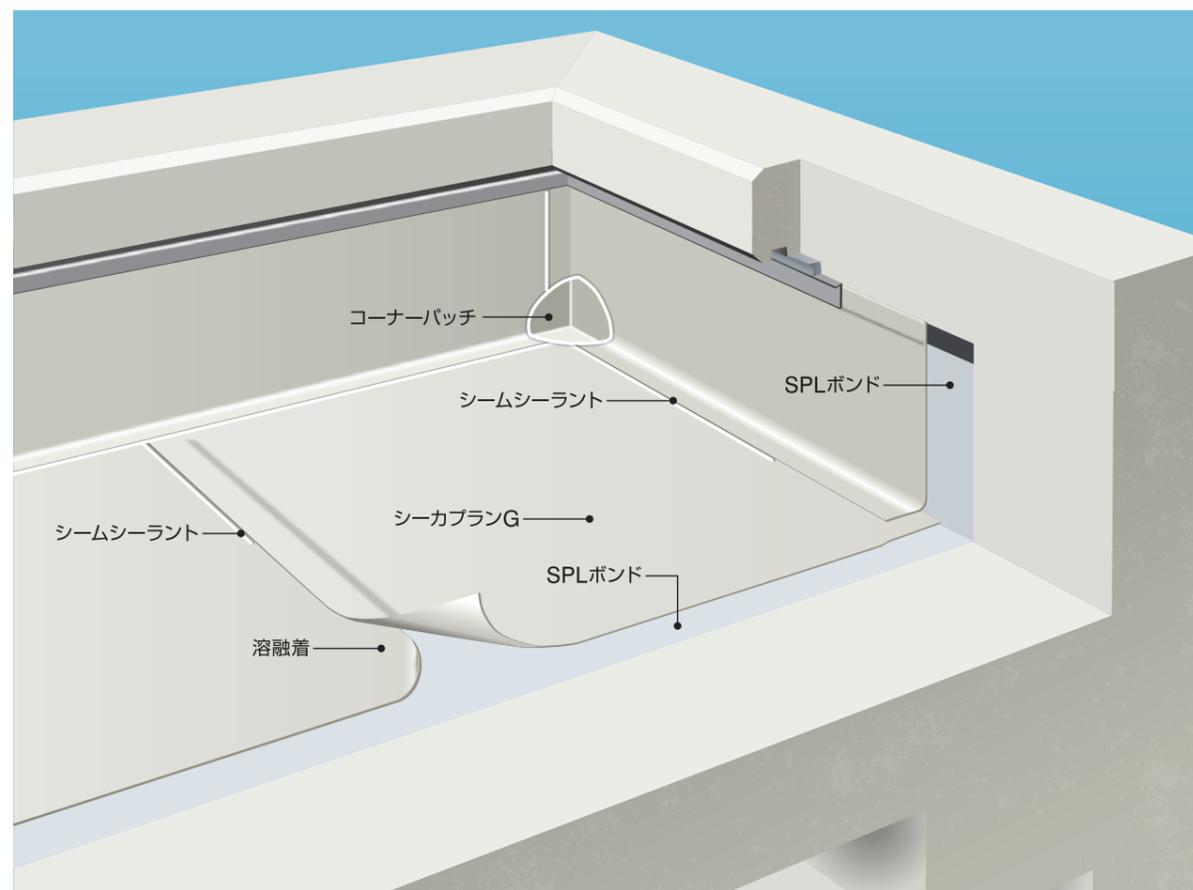
#### ※注意事項

- ・高層の建物(30m以上)や海岸地域に近い建物は別途IWディスク割付の検討が必要です。
- ・IWディスクの下に必ずIWディスクスペーサーを設置してください。
- ・非歩行仕様です。
- ・断熱材の厚みは50mm以下です。
- ・既存下地と断熱材の間にSPL防湿シートを敷設する場合があります。

# 9. 接着工法

システム記号	シート厚み	高反射	用途		適応下地	
			非歩行	歩行	RC	ALC
12G-FA	1.2	-	-	-	●	-
15G-FA	1.5	-	-	-	●	●
15GW-FA	1.5	●	-	-	●	●
20G-FA	2.0	-	●(ALC)	●	●	●
20GW-FA	2.0	●	●(ALC)	●	●	●

公共建築工事標準仕様書 S-F2  
 公共建築改修工事標準仕様書 S-F2  
 日本建築学会 JASS 8 S-PF



## ■ 施工手順

1. 下地処理(ALCパネルの場合)	Dワン・カチオン、SPLテープ
2. 接着剤塗布	SPLボンド
3. シーカプランG張込み	シーカプランG (高反射タイプ含む)
4. 溶融着接合	溶融着、シームシーラント
5. 端末処理	SPL-A各種、シーカフレックス M1、フィッシャー N5×30FZ、プチルテープ

※注意事項  
 ・下地がALCパネルなどの動きが予想される場合は、パネルの短辺方向の目地にPPテープを貼ります。  
 ・シートの厚みが2.0mmの場合は、歩行可能です。(但し、ALCパネル下地を除く)  
 ・下地がALCパネルの場合は、下地処理材ダイヤ1粉カチオンフィラーが必要です。

# 硬質ウレタンフォーム特寸タイプについて

シーカプラン断熱防水工法では断熱材としてポリスチレンフォームと硬質ウレタンフォームを採用しておりますが、硬質ウレタンフォームについては特寸法(以下特寸タイプ)も採用し、施工の省力化、施工品質の向上を図っていきます。特寸タイプの規格についてはIWディスク割付(600mm×750mm)の倍数にすることにより、IWディスクのみで断熱材とシートを固定できます。

	従来規格タイプ 910mm×1,820mm ポリスチレンフォーム、硬質ウレタンフォーム	特寸タイプ 1,200mm×1,500mm 硬質ウレタンフォーム																																										
ディスク盤標準割付比較																																												
工程比較	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ポリスチレンフォーム</th> <th>硬質ウレタンフォーム</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. 断熱材の敷設</td><td>1. 断熱材の敷設</td></tr> <tr><td>2. 断熱材を固定(2箇所/枚) (SPLディスク、SPLスクリュー使用)</td><td>2. 断熱材を固定(2箇所/枚) (SPLディスク、SPLスクリュー使用)</td></tr> <tr><td>3. 清掃</td><td>3. 清掃</td></tr> <tr><td>4. 絶縁シート敷設 (SPLエマルジョン、SPLテープ併用)</td><td></td></tr> <tr><td>5. IWディスクスペーサー</td><td>4. IWディスクスペーサー</td></tr> <tr><td>6. IWディスク固定</td><td>5. IWディスク固定</td></tr> <tr><td>7. 清掃</td><td>6. 清掃</td></tr> <tr><td>8. シーカプラン敷設</td><td>7. シーカプラン敷設</td></tr> </tbody> </table>	ポリスチレンフォーム	硬質ウレタンフォーム	1. 断熱材の敷設	1. 断熱材の敷設	2. 断熱材を固定(2箇所/枚) (SPLディスク、SPLスクリュー使用)	2. 断熱材を固定(2箇所/枚) (SPLディスク、SPLスクリュー使用)	3. 清掃	3. 清掃	4. 絶縁シート敷設 (SPLエマルジョン、SPLテープ併用)		5. IWディスクスペーサー	4. IWディスクスペーサー	6. IWディスク固定	5. IWディスク固定	7. 清掃	6. 清掃	8. シーカプラン敷設	7. シーカプラン敷設	<table border="1"> <thead> <tr> <th>硬質ウレタンフォーム特寸タイプ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. 断熱材の敷設</td></tr> <tr><td>2. IWディスクスペーサー</td></tr> <tr><td>3. IWディスク固定</td></tr> <tr><td>4. 清掃</td></tr> <tr><td>5. シーカプラン敷設</td></tr> </tbody> </table>	硬質ウレタンフォーム特寸タイプ	1. 断熱材の敷設	2. IWディスクスペーサー	3. IWディスク固定	4. 清掃	5. シーカプラン敷設																		
ポリスチレンフォーム	硬質ウレタンフォーム																																											
1. 断熱材の敷設	1. 断熱材の敷設																																											
2. 断熱材を固定(2箇所/枚) (SPLディスク、SPLスクリュー使用)	2. 断熱材を固定(2箇所/枚) (SPLディスク、SPLスクリュー使用)																																											
3. 清掃	3. 清掃																																											
4. 絶縁シート敷設 (SPLエマルジョン、SPLテープ併用)																																												
5. IWディスクスペーサー	4. IWディスクスペーサー																																											
6. IWディスク固定	5. IWディスク固定																																											
7. 清掃	6. 清掃																																											
8. シーカプラン敷設	7. シーカプラン敷設																																											
硬質ウレタンフォーム特寸タイプ																																												
1. 断熱材の敷設																																												
2. IWディスクスペーサー																																												
3. IWディスク固定																																												
4. 清掃																																												
5. シーカプラン敷設																																												
使用材料比較(1000㎡想定)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ポリスチレンフォーム</th> <th>硬質ウレタンフォーム</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>断熱材</td><td>603枚</td><td>603枚</td></tr> <tr><td>SPLディスク</td><td>1210か所</td><td>1210か所</td></tr> <tr><td>SPLスクリュー</td><td>1000m</td><td>0</td></tr> <tr><td>SPLマット</td><td>1200m</td><td>0</td></tr> <tr><td>IWディスク</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>IWディスクスペーサー</td><td>1400か所</td><td>1400か所</td></tr> <tr><td>SPLスクリュー</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		ポリスチレンフォーム	硬質ウレタンフォーム	断熱材	603枚	603枚	SPLディスク	1210か所	1210か所	SPLスクリュー	1000m	0	SPLマット	1200m	0	IWディスク			IWディスクスペーサー	1400か所	1400か所	SPLスクリュー			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>硬質ウレタンフォーム特寸タイプ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>断熱材</td><td>556枚</td></tr> <tr><td>SPLディスク</td><td>0か所</td></tr> <tr><td>SPLスクリュー</td><td>0</td></tr> <tr><td>SPLマット</td><td>0</td></tr> <tr><td>SPLテープ</td><td>0</td></tr> <tr><td>IWディスク</td><td></td></tr> <tr><td>IWディスクスペーサー</td><td>1800か所</td></tr> <tr><td>SPLスクリュー</td><td></td></tr> </tbody> </table>		硬質ウレタンフォーム特寸タイプ	断熱材	556枚	SPLディスク	0か所	SPLスクリュー	0	SPLマット	0	SPLテープ	0	IWディスク		IWディスクスペーサー	1800か所	SPLスクリュー	
	ポリスチレンフォーム	硬質ウレタンフォーム																																										
断熱材	603枚	603枚																																										
SPLディスク	1210か所	1210か所																																										
SPLスクリュー	1000m	0																																										
SPLマット	1200m	0																																										
IWディスク																																												
IWディスクスペーサー	1400か所	1400か所																																										
SPLスクリュー																																												
	硬質ウレタンフォーム特寸タイプ																																											
断熱材	556枚																																											
SPLディスク	0か所																																											
SPLスクリュー	0																																											
SPLマット	0																																											
SPLテープ	0																																											
IWディスク																																												
IWディスクスペーサー	1800か所																																											
SPLスクリュー																																												

塩ビシート+ウレタン塗膜防水複合仕様

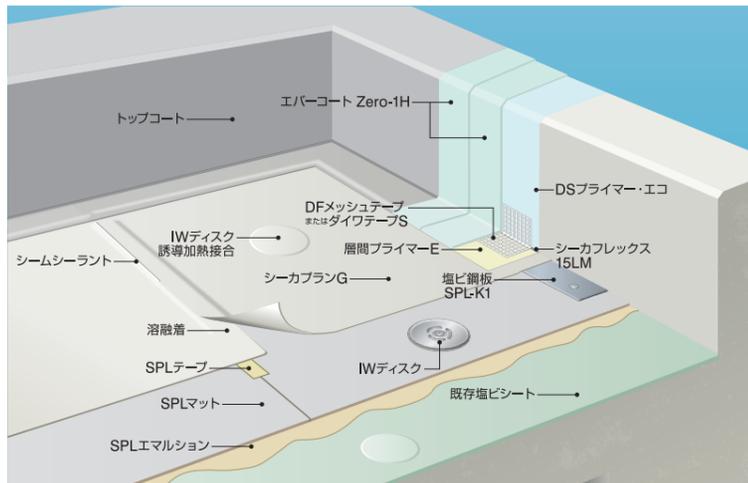
# シーカプランとエバーコートZero-1 H 高品質なコラボレーション

高品質な塩ビシートシステム (平場)と1成分形ウレタン塗膜防水材(立上り)の理想的な組み合わせです。

高耐久な塩ビシートで高い施工品質を誇る「シーカプラン防水システム」を平場に施し、多様な形状がある立上りには、施工効率・品質に優れる1成分形ウレタン塗膜防水「エバーコートZero-1H」を施すことにより、シートと塗膜防水材の長所を徹底的に生かした新発想の防水システムです。改修工事ではもとより、新築工事における外断熱工法では金属笠木などパラペット防水納まりのさまざまな制約からデザインを開放し、居室空間の確保をはじめ様々なメリットがあります。

## 非断熱工法

### ■ 基本構成図



平場部：シーカプラン  
塩ビシート防水機械的固定(IW)工法

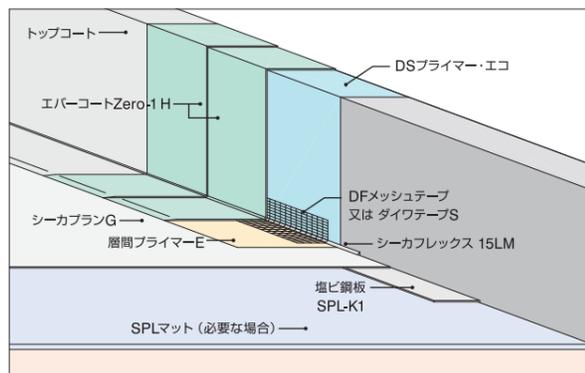
システム記号	シート厚み	用途	適応下地
12G-IW	1.2	非歩行	RC
15G (W) -IW	1.5	非歩行	RC/ALC
20G (W) -IW	2.0	歩行	RC/ALC

立上り部：エバーコートZero-1 H  
1成分形ウレタン塗膜防水材密着工法

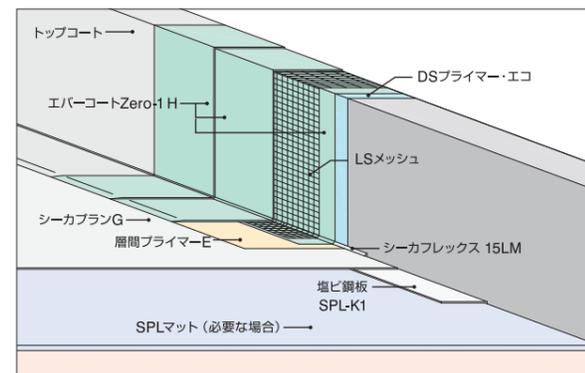
システム記号	シート厚み	適応下地	備考
ZHM-200L	2.0	RC/ALC	メッシュ無
ZHM-200LM	2.0	RC/ALC	メッシュ有

### ■ 取り合い部詳細

立上り部：エバーコートZero-1 H ZHM-200L(メッシュ無し入隅補強)



立上り部：エバーコートZero-1 H ZHM-200LM (メッシュ有り)



### ■ 施工手順 (シーカプランの施工手順はp.23 ~ 26を参照ください。)

立上り部：エバーコートZero-1H 1成分形ウレタン塗膜防水材密着工法  
ZHM-200L：メッシュ無し(入隅補強)

工程	使用材料	使用量
1	コンクリート下地：DSプライマー・エコ	0.2kg /㎡
	シーカプラン下地：層間プライマーE	0.15kg /㎡
2	DFメッシュテープ または ダイワテープS	—
3	エバーコートZero-1 H	1.3kg /㎡
4	エバーコートZero-1 H	1.3kg /㎡
5	各種トップコート	0.2kg /㎡

ZHM-200LM：メッシュ有り

工程	使用材料	使用量
1	コンクリート下地：DSプライマー・エコ	0.2kg /㎡
	シーカプラン下地：層間プライマーE	0.15kg /㎡
2	エバーコートZero-1 H	0.4kg /㎡
3	LSメッシュ	1.1m /㎡
4	エバーコートZero-1 H	1.1kg /㎡
5	エバーコートZero-1 H	1.1kg /㎡
6	各種トップコート	0.2kg /㎡

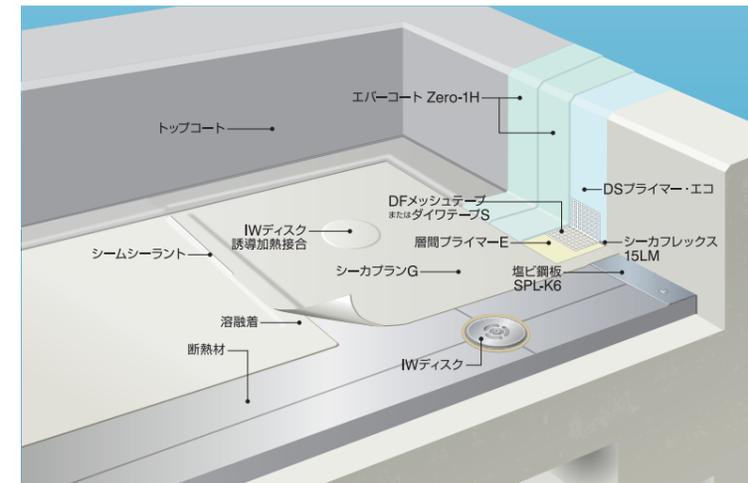
※各種下地に応じたプライマーを使用してください。

※注意事項

- ・ウレタン塗膜防水施工前に入隅部塩ビ鋼板端部は必ずウレタン系シーリング材を充填してください。(シーカフレックス 15LM推奨)
- ・シーカプランGとエバーコートZero-1Hの取り合い部は必ず層間プライマー Eを使用し、ラップ幅は100mm以上としてください。

## 断熱工法

### ■ 基本構成図



平場部：シーカプラン  
塩ビシート防水断熱機械的固定(IW)工法

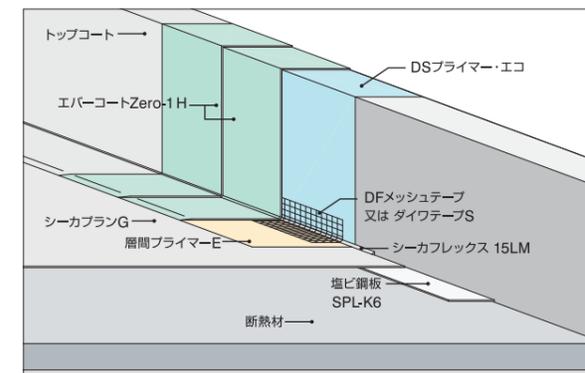
システム記号	シート厚み	用途	適応下地
12G-IW-S 又はUR	1.2	非歩行	RC
15G (W) -IW-S 又はUR	1.5	非歩行	RC
20G (W) -IW-S 又はUR	2.0	非歩行	RC

立上り部：エバーコートZero-1 H  
1成分形ウレタン塗膜防水材密着工法

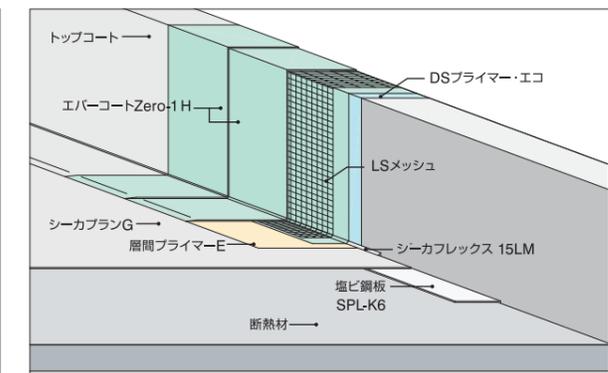
システム記号	シート厚み	適応下地	備考
ZHM-200L	2.0	RC/ALC	メッシュ無
ZHM-200LM	2.0	RC/ALC	メッシュ有

### ■ 取り合い部詳細

立上り部：エバーコートZero-1 H ZHM-200L(メッシュ無し入隅補強)



立上り部：エバーコートZero-1 H ZHM-200LM (メッシュ有り)



### ■ 施工手順 (シーカプランの施工手順はp.27 ~ 30を参照ください。)

立上り部：エバーコートZero-1H 1成分形ウレタン塗膜防水材密着工法  
ZHM-200L：メッシュ無し(入隅補強)

工程	使用材料	使用量
1	コンクリート下地：DSプライマー・エコ	0.2kg /㎡
	シーカプラン下地：層間プライマーE	0.15kg /㎡
2	DFメッシュテープ または ダイワテープS	—
3	エバーコートZero-1 H	1.3kg /㎡
4	エバーコートZero-1 H	1.3kg /㎡
5	各種トップコート	0.2kg /㎡

ZHM-200LM：メッシュ有り

工程	使用材料	使用量
1	コンクリート下地：DSプライマー・エコ	0.2kg /㎡
	シーカプラン下地：層間プライマーE	0.15kg /㎡
2	エバーコートZero-1 H	0.4kg /㎡
3	LSメッシュ	1.1m /㎡
4	エバーコートZero-1 H	1.1kg /㎡
5	エバーコートZero-1 H	1.1kg /㎡
6	各種トップコート	0.2kg /㎡

※各種下地に応じたプライマーを使用してください。

※注意事項

- ・ウレタン塗膜防水施工前に入隅部塩ビ鋼板端部は必ずウレタン系シーリング材を充填してください。(シーカフレックス 15LM推奨)
- ・シーカプランGとエバーコートZero-1Hの取り合い部は必ず層間プライマー Eを使用し、ラップ幅は100mm以上としてください。